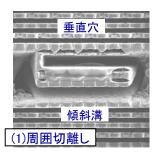
マイクロサンプリング法

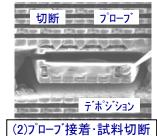
FIB: 集束イオンビーム加工

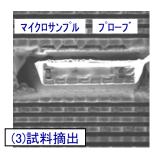
概要

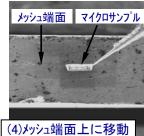
■概要・手順

試料から直接小片を取り出し(マイクロサンプリング)、FIB加工を行うことができます。

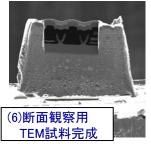












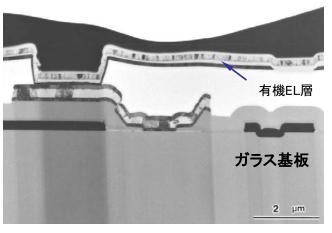
SIM像提供:(株)日立ハイテクノロジーズ

■特徴

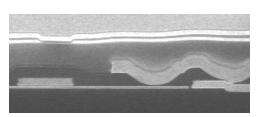
- ・耐水性が無い、剥離し易い等の難ダイシング材料からのサンプリングができます。
- ・近接した複数の断面をTEM試料にできます。
- ・微小チップからのサンプリングに有効です。
- ·EDX分析の際、基板の影響が軽減されます。
- ·同一箇所の直交2断面からのTEM観察も可能です。

データ例:有機EL素子

■有機EL層部



■TFT部



シボサービスで、あたたの研究開発を強力サポート

IVIST 材料科学技術振興財団

URL : http://www.mst.or.jp/